



2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年5月13日

東

上場会社名 株式会社 東京精密

上場取引所

コード番号 7729

URL <https://www.accrettech.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長CEO

(氏名) 木村 龍一

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員常務CFO

(氏名) 小泉 公人

TEL 042-642-1701

定時株主総会開催予定日 2026年6月22日

配当支払開始予定日

2026年6月23日

有価証券報告書提出予定日 2026年6月19日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期の連結業績 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	166,839	10.8	33,738	13.6	34,825	16.3	24,739	△3.5
2025年3月期	150,534	11.8	29,703	17.4	29,939	13.2	25,637	32.3

(注) 包括利益 2026年3月期 26,038百万円 (△1.7%) 2025年3月期 26,486百万円 (25.2%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	610.02	606.14	13.6	14.3	20.2
2025年3月期	633.75	628.31	15.5	12.9	19.7

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 一百万円 2025年3月期 一百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	249,917	192,205	76.2	4,689.22
2025年3月期	237,952	176,229	73.2	4,305.52

(参考) 自己資本 2026年3月期 190,324百万円 2025年3月期 174,221百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	25,012	△11,491	△15,674	53,052
2025年3月期	28,824	2,541	△13,991	54,516

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2025年3月期	—	114.00	—	139.00	253.00	10,287	40.1	5.8
2026年3月期	—	111.00	—	151.00	262.00	10,682	43.2	5.6
2027年3月期(予想)	—	138.00	—	138.00	276.00		40.0	

3. 2027年3月期の連結業績予想 (2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり当期純 利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	87,500	13.5	18,700	27.1	18,700	24.8	13,100	36.3	322.76
通 期	181,500	8.8	40,000	18.6	40,000	14.9	28,000	13.2	689.87

※ 注記事項

- (1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 有
新規 一社(社名)
除外 一社(社名)株式会社アクレーテック・パワトロシステム
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期	42,282,881株	2025年3月期	42,170,081株
② 期末自己株式数	2026年3月期	1,695,286株	2025年3月期	1,705,289株
③ 期中平均株式数	2026年3月期	40,554,349株	2025年3月期	40,453,797株

(注) 当社は2025年3月期中間期より株式給付信託(BBT)を導入しており、期末自己株式数については、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(2026年3月期 189,700株、2025年3月期 200,000株)が含まれています。また、期中平均株式数の算定上控除する自己株式については当該信託が保有する当社株式(2026年3月期 193,541株、2025年3月期 200,000株)が含まれています。

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年3月期の個別業績(2025年4月1日～2026年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	143,826	11.8	24,893	15.1	29,469	19.7	24,122	4.9
2025年3月期	128,647	16.2	21,623	24.7	24,620	15.0	22,998	36.7

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期	594.81	591.03
2025年3月期	568.50	563.63

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	210,712	156,951	74.2	3,850.67
2025年3月期	199,707	142,373	70.8	3,494.96

(参考) 自己資本 2026年3月期 156,289百万円 2025年3月期 141,422百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し等をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	4
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	5
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	5
3. 連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 連結貸借対照表	6
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	8
連結損益計算書	8
連結包括利益計算書	9
(3) 連結株主資本等変動計算書	10
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	12
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記)	14
(セグメント情報)	15
(1株当たり情報)	17
(重要な後発事象)	17
4. 補足情報	18
(1) 生産、受注及び販売の状況	18

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

[全般]

当連結会計年度の世界経済は、年度前半において米国では個人消費を中心に内需が底堅く推移し、日本および欧州でも緩やかな持ち直しが見られるなど、全体として回復基調で推移しました。年度後半にかけては、通商政策の動向等を背景とした貿易面の不透明感が強まったほか、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー関連コストの上昇リスクが意識されるなど、先行きリスクが高まる状況となりました。

このような環境下で当社を取り巻く状況は、AIやテクノロジー関連の設備投資の増加により、生成AIを含むHPC(High Performance Computing)関連の需要が高まり、半導体製造装置部門で前期比の増収につながりました。計測機器部門でも国内のものづくり関連投資が安定推移したうえ、航空・宇宙・防衛分野の事業機会を新たに獲得したことで、こちらも前期比で増収となりました。

インフレやエネルギー関連コストの上昇に伴い部材費や人件費が上昇したものの、既往ピークの売上高により営業利益、経常利益も前期比で増加し、第2四半期に半導体製造装置部門の一部製品に関する不具合対策費用を特別損失として計上したものの、純利益は前期比でほぼ同水準となりました。なお、中東情勢の悪化が当連結会計年度の事業活動に与えた影響は軽微でした。

その結果、当連結会計年度の連結業績は受注高 1,630 億 96 百万円（前期比12.0 %増）、売上高 1,668 億 39 百万円（前期比10.8 %増）となり、利益面では、営業利益 337 億 38 百万円（前期比13.6 %増）、経常利益 348 億 25 百万円（前期比16.3 %増）、親会社株主に帰属する当期純利益 247 億 39 百万円（前期比3.5 %減）となりました。

当連結会計年度の事業別セグメントの状況は以下のとおりです。

[事業別セグメントの状況]

A. 半導体製造装置部門

半導体製造装置部門の受注高は、期を通じてHBM(High Bandwidth Memory, 広帯域メモリ)向けプロローバやAIパッケージング工程に向けたグラインダの引き合いが底堅く推移したこと、中国における高精度装置の要求が継続したこと等により前期比で増加しました。

売上高は、概ね顧客要求納期に沿った出荷を進めることができたことに加え、付加価値の高いプロローバの出荷も増加し、既往ピークを更新しました。地域別には、プロローバは韓国、台湾、中国など、グラインダ・ダイサ等の加工装置は台湾、中国、日本などで堅調でした。

こうしたなか、研究・開発面では、引き続き顧客の先端ニーズに対応した製品開発や将来を見据えた要素技術開発を進めました。生産面では、長期的な加工装置需要の拡大を見据えた名古屋工場が竣工し、生産キャパシティが増加しました。

この結果、当連結会計年度における当部門業績は、受注高 1,233 億 96 百万円（前期比14.6 %増）、売上高 1,278 億 78 百万円（前期比12.7 %増）、営業利益 284 億 4 百万円（前期比16.8 %増）となりました。

B. 計測機器部門

計測機器部門の受注高は、期を通じて既存設備の更新需要が安定的に推移したことや、後半にかけてハイブリッド車生産に関連した追加投資、また航空・宇宙・防衛など成長が見込まれる業界向けの案件を獲得したこと等により、前年同期比で増加し、既往ピークを更新しました。

売上高は、獲得した受注を顧客要求納期に沿って計画的な出荷に繋げた結果、前期比で増加し、同様に既往ピークを更新しました。

こうしたなか、研究・開発面では、引き続きオートメーション化に向けた汎用計測機器とロボットとのコラボレーションの取り組みなどを進めたほか、半導体製造装置部門の製品とのシナジー効果を拡大させる施策を進めました。

この結果、当連結会計年度における当部門業績は、受注高 397 億円（前期比4.7 %増）、売上高 389 億 60 百万円（前期比5.1 %増）、営業利益 53 億 33 百万円（前期比1.1 %減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 119 億 65 百万円 増加し、2,499 億 17 百万円となりました。その主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権の増加 80 億 67 百万円、有形固定資産の増加 59 億 70 百万円、製品、原材料、仕掛品等の棚卸資産の減少 14 億 90 百万円、現金及び預金の減少 14 億 67 百万円等です。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ 40 億 11 百万円減少し、577 億 12 百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の減少 50 億円、未払法人税等の減少 17 億 72 百万円等です。

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 159 億 76 百万円増加し、1,922 億 5 百万円となりました。自己資本比率は、76.2%となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 14 億 63 百万円減少し、530 億 52 百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、250 億 12 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 331 億 86 百万円、法人税等の支払額 107 億 58 百万円、減価償却費 55 億 82 百万円、売上債権の増加 70 億 93 百万円、棚卸資産の減少 19 億 39 百万円等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、114 億 91 百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 109 億 90 百万円、無形固定資産の取得による支出 6 億 43 百万円等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、156 億 74 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額 101 億 77 百万円、長期借入金の返済による支出 50 億円等によるものです。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです

	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率 (%)	69.4	73.2	76.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	225.0	139.5	214.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	5.1	0.7	0.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	192.7	181.4	168.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

注1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しています。

注3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。

注4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

(4) 今後の見通し

[全般及び事業別セグメントの概況]

当社は、2026年3月期から2028年3月期の中期経営計画を実行しています。パーパス「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」および東京精密グループ長期ビジョン2050「高度な技術力と豊かな創造性で未体験の未来を切り拓く」を実現するため、持続的な成長に向けた足場固めとインフラ整備を強化することを前提としています。

基本方針は次のとおりです。

- ・ 戦略製品の成長促進
- ・ 計測・半導体の技術シナジー追求
- ・ リカーリングビジネス強化
- ・ これらを支える事業基盤の強化

定量目標は、売上高 1,850 億円、営業利益 450 億円、ROE 15%と設定しています。

2か年目となる次期（2027年3月期）は、特に半導体製造装置市場において生成AIを含むHPC関連装置の需要が継続・成長すると見込まれ、当社の業容も拡大すると想定しております。半導体製造装置を中心に事業環境は拡大が見込まれ、上記中期経営計画で想定した良好な市場環境は、次期の段階で一定程度実現するものと考えています。中東情勢の緊迫化は、サプライチェーンの停滞や出荷遅延などのリスクを伴いますが、現時点で各事業セグメントの業績への影響を合理的に見積もることが困難であるため、予想に織り込んでいません。

次期 2027年3月期の連結業績予想は以下のとおりです。

		中間期	通期
売 上 高		875 億円(前年同期比 13.5%増)	1,815 億円(前年同期比 8.8%増)
	半導体製造装置	690 億円(前年同期比 16.1%増)	1,415 億円(前年同期比 10.7%増)
	計測機器	185 億円(前年同期比 4.8%増)	400 億円(前年同期比 2.7%増)
営 業 利 益		187 億円(前年同期比 27.1%増)	400 億円(前年同期比 18.6%増)
経 常 利 益		187 億円(前年同期比 24.8%増)	400 億円(前年同期比 14.9%増)
親会社株主に帰属する当期純利益		131 億円(前年同期比 36.3%増)	280 億円(前年同期比 13.2%増)

各セグメントの概況は以下のとおりです。

A. 半導体製造装置部門

次期の半導体製造装置部門の業況は、前期から続く生成AIを含むHPC関連需要の更なる拡大が続くと見込むほか、汎用メモリや、ASIC(Application Specific Integrated Circuit、特定用途向け集積回路)を含むロジック半導体の生産拡大に向けた顧客の投資が加速すると想定すること等により、概ね堅調に推移すると見込んでいます。これら半導体デバイスの高精度化に伴い、特に検査装置（プローバ）を中心に技術要求が高まっており、対応する高付加価値製品の出荷比率が上昇すると想定しています。以上から、当部門では当期比での増収を見込んでいます。また、高付加価値製品の売上比率拡大による増益も期待しています。

これに応えるため、研究・開発面では、顧客の最先端要求に応えるべく製品開発とそれを支える要素技術をさらに強化・拡充してまいります。販売面では、顧客ニーズを迅速に把握して開発へ反映するため、海外のデモセンター設備の強化を進めます。生産面では、検査装置の製造を担う飯能工場（埼玉県）の近隣に新工場を建設する取り組みを進めるほか、長期的な需要増を踏まえ、八王子市（東京都）に新たな生産拠点を設立する準備を進めてまいります。

B. 計測機器部門

計測機器部門の事業環境は、NEV(電気自動車)への移行が当初の想定より緩やかに推移することが充放電試験システムの急速な普及に向かい風とみる一方、ハイブリッド車への回帰に伴う設備投資が加速すると見込まれます。また、当社が注力する分野である航空・宇宙・防衛分野、エネルギー分野や、半導体製造装置業界の活性化に伴う引合いの増加も見込んでいます。さらに、当部門の先行指標となりうる工作機械の受注動向が緩やかな回復基調を維持すると見込まれることから、全体としてゆるやかな成長基調が続くものと想定しています。

当社は、これらの需要を獲得するため、半導体製造装置部門とのシナジー拡大に向けた新製品・新機能の開発に注力します。加えて、汎用・自動計測機器、充放電試験システム、X線CTシステムなど幅広い機器を組み合わせたオートメーションソリューションの強化に努めてまいります。

(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、半導体製造装置と計測機器において、最先端技術を駆使した世界No.1商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えており、剰余金の配当につきましては、下記記載の株主還元方針に基づき決定しております。

当期末の1株当たり配当は、当期に計上した半導体製造装置部門の一部製品に関する不具合対策費用(特別損失)を控除したものと仮定した利益、ならびに下記株主還元方針「連結配当性向40%程度」を踏まえ、2026年2月6日に公表しました配当予想1株当たり 111 円から 40 円増配し、151 円とさせていただきますことを予定しております。

この結果、当期の1株当たり年間配当金は、2025年12月8日に実施済みの中間配当 111 円と合わせ 262 円となります。

次期(2027年3月期)の剰余金の配当につきましては、下記株主還元方針ならびに次期連結業績予想に基づき、中間配当1株あたり 138 円、期末配当1株あたり 138 円を予定しております。何卒、ご理解のほどお願いいたします。

【株主還元方針】

当社は、最先端技術を駆使した世界No.1商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を行うことを経営の重要課題と考えています。

剰余金の配当につきましては、業績に連動した利益配分を基本に、連結配当性向40%を目安として実施していく考えです。また、安定的・継続的に配当を行うよう努めていく観点から、連結利益水準にかかわらず年20円の配当は維持してまいります。但し2期連続赤字になる場合は、見直す可能性があります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としています。

内部留保資金につきましては、財務体質の健全性の維持・強化に十分配慮しつつ、先進技術の研究開発や設備投資、海外展開、情報システムの高度化、新規事業分野の開拓、M&A投資等に有効に活用してまいります。

なお、自己株式の取得につきましては、キャッシュ・フローや内部留保の状況等を総合的に勘案しつつ、剰余金の配当を補完する機動的な利益還元策と位置づけています。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針です。

国際財務報告基準(IFRS)適用につきましては、日本基準のコンバージェンスの動向やIFRS自体の改訂状況など国内外の諸情勢を考慮のうえ、適切に対応していく方針です。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	54,541	53,073
受取手形、売掛金及び契約資産	33,122	42,524
電子記録債権	6,687	5,353
商品及び製品	2,856	3,416
仕掛品	40,053	40,373
原材料及び貯蔵品	26,603	24,232
その他	5,523	5,717
貸倒引当金	△46	△83
流動資産合計	169,341	174,607
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	48,425	57,906
減価償却累計額	△20,824	△22,924
建物及び構築物（純額）	27,600	34,982
機械装置及び運搬具	11,742	12,575
減価償却累計額	△9,291	△9,880
機械装置及び運搬具（純額）	2,451	2,694
工具、器具及び備品	13,834	15,471
減価償却累計額	△9,223	△10,290
工具、器具及び備品（純額）	4,611	5,180
土地	13,439	13,691
リース資産	1,381	1,006
減価償却累計額	△633	△605
リース資産（純額）	747	401
建設仮勘定	5,125	2,996
有形固定資産合計	53,975	59,946
無形固定資産		
のれん	224	183
リース資産	17	3
その他	3,486	3,001
無形固定資産合計	3,729	3,189
投資その他の資産		
投資有価証券	3,246	4,307
長期貸付金	138	25
退職給付に係る資産	2,936	2,710
繰延税金資産	4,104	4,549
その他	591	582
貸倒引当金	△112	-
投資その他の資産合計	10,906	12,174
固定資産合計	68,610	75,309
資産合計	237,952	249,917

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,301	9,085
電子記録債務	8,364	8,443
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	5,000	5,000
リース債務	327	261
未払法人税等	5,826	4,054
契約負債	6,789	6,486
賞与引当金	2,655	3,453
役員賞与引当金	19	-
製品不具合対策引当金	-	1,688
その他	8,348	8,105
流動負債合計	46,933	47,879
固定負債		
長期借入金	13,000	8,000
リース債務	456	151
役員退職慰労引当金	54	64
退職給付に係る負債	811	877
資産除去債務	104	105
その他	361	633
固定負債合計	14,789	9,832
負債合計	61,723	57,712
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,573	11,748
資本剰余金	23,161	23,336
利益剰余金	141,546	156,094
自己株式	△8,430	△8,362
株主資本合計	167,850	182,816
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,030	1,534
為替換算調整勘定	4,306	5,209
退職給付に係る調整累計額	1,034	764
その他の包括利益累計額合計	6,371	7,508
新株予約権	950	662
非支配株主持分	1,056	1,218
純資産合計	176,229	192,205
負債純資産合計	237,952	249,917

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	150,534	166,839
売上原価	88,081	97,978
売上総利益	62,453	68,860
販売費及び一般管理費	32,750	35,122
営業利益	29,703	33,738
営業外収益		
受取利息	64	63
受取配当金	258	236
投資事業組合運用益	66	221
為替差益	-	646
受取補償金	220	21
補助金収入	59	89
その他	251	202
営業外収益合計	921	1,481
営業外費用		
支払利息	202	214
輸送事故による損失	81	19
固定資産除売却損	0	3
為替差損	247	-
支払補償金	-	67
その他	152	89
営業外費用合計	684	394
経常利益	29,939	34,825
特別利益		
投資有価証券売却益	179	191
新株予約権戻入益	10	3
固定資産売却益	4,303	-
特別利益合計	4,493	194
特別損失		
割増退職金	117	-
関係会社清算損	40	-
製品不具合対策費	-	1,833
特別損失合計	158	1,833
税金等調整前当期純利益	34,275	33,186
法人税、住民税及び事業税	9,329	8,945
法人税等調整額	△798	△590
法人税等合計	8,531	8,354
当期純利益	25,744	24,831
非支配株主に帰属する当期純利益	106	92
親会社株主に帰属する当期純利益	25,637	24,739

連結包括利益計算書

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	25,744	24,831
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	40	503
為替換算調整勘定	796	973
退職給付に係る調整額	△95	△270
その他の包括利益合計	741	1,206
包括利益	26,486	26,038
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	26,214	25,875
非支配株主に係る包括利益	271	162

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	11,450	22,593	124,705	△7,983	150,765
当期変動額					
新株の発行	122	122			245
剰余金の配当			△8,796		△8,796
親会社株主に帰属 する当期純利益			25,637		25,637
自己株式の取得				△1,383	△1,383
自己株式の処分		444		936	1,381
その他					—
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)					—
当期変動額合計	122	567	16,841	△446	17,084
当期末残高	11,573	23,161	141,546	△8,430	167,850

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	989	3,674	1,130	5,794	1,082	784	158,427
当期変動額							
新株の発行							245
剰余金の配当							△8,796
親会社株主に帰属 する当期純利益							25,637
自己株式の取得							△1,383
自己株式の処分							1,381
その他							—
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)	40	631	△95	576	△131	271	716
当期変動額合計	40	631	△95	576	△131	271	17,801
当期末残高	1,030	4,306	1,034	6,371	950	1,056	176,229

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	11,573	23,161	141,546	△8,430	167,850
当期変動額					
新株の発行	175	175			350
剰余金の配当			△10,177		△10,177
親会社株主に帰属 する当期純利益			24,739		24,739
自己株式の取得				△3	△3
自己株式の処分		0		71	71
その他			△14		△14
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	175	175	14,547	67	14,965
当期末残高	11,748	23,336	156,094	△8,362	182,816

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	1,030	4,306	1,034	6,371	950	1,056	176,229
当期変動額							
新株の発行							350
剰余金の配当							△10,177
親会社株主に帰属 する当期純利益							24,739
自己株式の取得							△3
自己株式の処分							71
その他							△14
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	503	903	△270	1,136	△288	162	1,010
当期変動額合計	503	903	△270	1,136	△288	162	15,976
当期末残高	1,534	5,209	764	7,508	662	1,218	192,205

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	34,275	33,186
減価償却費	5,105	5,582
のれん償却額	49	45
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△130	35
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	10	9
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14	△81
受取利息及び受取配当金	△322	△300
支払利息	202	214
補助金収入	△59	△89
支払補償金	-	67
受取補償金	△220	△21
投資有価証券売却損益 (△は益)	△179	△191
投資事業組合運用損益 (△は益)	△66	△221
訴訟損失引当金の増減額 (△は減少)	△960	-
固定資産売却損益 (△は益)	△4,303	3
割増退職金	117	-
関係会社清算損	40	-
売上債権の増減額 (△は増加)	3,033	△7,093
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,089	1,939
仕入債務の増減額 (△は減少)	△958	△209
契約負債の増減額 (△は減少)	△3,185	△548
製品不具合対策引当金の増減額 (△は減少)	-	1,688
その他	4,141	1,555
小計	34,513	35,572
利息及び配当金の受取額	324	300
利息の支払額	△192	△212
補助金の受取額	59	89
割増退職金の支払額	△117	-
補償金の受取額	220	21
法人税等の支払額	△5,942	△10,758
その他	△40	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△435	△31
定期預金の払戻による収入	458	35
有形固定資産の取得による支出	△9,574	△10,990
有形固定資産の売却による収入	12,017	33
無形固定資産の取得による支出	△660	△643
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	647	364
関係会社株式の取得による支出	-	△500
投資事業組合への出資による支出	△11	△35
投資事業組合からの分配による収入	101	281
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	0	1
敷金及び保証金の差入による支出	△14	△10
敷金及び保証金の回収による収入	16	10
その他	-	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,541	△11,491

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△5,000	△5,000
リース債務の返済による支出	△317	△559
ストックオプションの行使による収入	124	65
配当金の支払額	△8,796	△10,177
自己株式の売却による収入	1,381	1
自己株式の取得による支出	△1,383	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,991	△15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額	404	689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,779	△1,463
現金及び現金同等物の期首残高	36,736	54,516
現金及び現金同等物の期末残高	54,516	53,052

- (5) 連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。

(セグメント情報)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。当社では、半導体社及び計測社の社内カンパニーそれぞれがその取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。

従って、当社は社内カンパニーを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「計測機器」の2つを報告セグメントとしています。

「半導体製造装置」は、半導体製造工程で使用される加工・検査装置を製造販売し、「計測機器」は三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機等の精密測定機器類を製造販売しています。

② 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理は連結財務諸表の作成方法と概ね同一であり、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。なお、全社資産については各報告セグメントに配分をしていません。

③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	半導体製造装置	計測機器	計		
売上高					
外部顧客への売上高	113,481	37,053	150,534	—	150,534
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	113,481	37,053	150,534	—	150,534
セグメント利益	24,311	5,392	29,703	—	29,703
セグメント資産	179,567	56,960	236,528	1,424	237,952
その他の項目					
減価償却額	3,670	1,435	5,105	—	5,105
のれんの償却額	9	39	49	—	49
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,590	3,655	10,245	—	10,245

(注) 1 セグメント資産の調整額は各報告セグメントに配分していない全社資産である長期投資資金(その他有価証券)等です。

2 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	半導体製造装置	計測機器	計		
売上高					
外部顧客への売上高	127,878	38,960	166,839	—	166,839
セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	127,878	38,960	166,839	—	166,839
セグメント利益	28,404	5,333	33,738	—	33,738
セグメント資産	189,851	57,413	247,264	2,652	249,917
その他の項目					
減価償却額	3,840	1,741	5,582	—	5,582
のれんの償却額	6	39	45	—	45
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,224	3,844	11,069	—	11,069

(注) 1 セグメント資産の調整額は各報告セグメントに配分していない全社資産である長期投資資金(その他有価証券)等です。

2 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と一致しています。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	4,305.52円	4,689.22円
1株当たり当期純利益	633.75円	610.02円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	628.31円	606.14円

(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託 (BBT)」に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度200,000株、当連結会計年度193,541株です。

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額 (百万円)	176,229	192,205
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	2,007	1,881
(うち新株予約権 (百万円))	(950)	(662)
(うち非支配株主持分 (百万円))	(1,056)	(1,218)
普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)	174,221	190,324
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株)	40,464	40,587

3. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	25,637	24,739
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	25,637	24,739
普通株式の期中平均株式数 (千株)	40,453	40,554
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数 新株予約権 (千株)	350	259
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
半導体製造装置	104,680	118,160
計測機器	30,548	32,009
合計	135,228	149,747

(注) 1 上記生産実績は販売価額によります。
 2 上記金額には消費税等は含まれていません。

②受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	107,713	69,630	123,396	65,149
計測機器	37,917	13,470	39,700	14,210
合計	145,631	83,101	163,096	79,359

(注) 上記金額には消費税等は含まれていません。

③販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
半導体製造装置	113,481	127,878
計測機器	37,053	38,960
合計	150,534	166,839